

镀青铜板晶粒度检测 抗拉强度测试

产品名称	镀青铜板晶粒度检测 抗拉强度测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	检测标准:YS/T347-2020 服务:一站式检测范围 报告语言:中英文可选
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

铜及铜合金平均晶粒度测定方法

1范围

本标准规定了铜及铜合金平均晶粒度的表示及测定方法,包含有比较法、面积法和截距法。本标准适用于测定单相或以单相为主的铜及铜合金的晶粒度。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注明日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其*新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 30067金相学术语

YS/T 449铜及铜合金铸造和加工制品显微组织检验方法

3术语和定义

GB/T 30067界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

晶界grain boundary

对于多晶材料,从一个结晶方向至另一个结晶方向过渡的很窄的区域,从而将相邻的晶粒分离。

3.2

晶粒grain

晶界所包围的整个区域。即是二维面上所观察到的原始晶界范围内的面积,或是三维物体上原始晶界面内所包围的体积。对于有孪晶界面材料,孪晶界面不予考虑。

3.3

孪晶twin grains

两个晶体(或一个晶体的两部分)沿一个公共晶面(即特定取向关系)构成镜面对称的位向关系,这两个晶体就称为“孪晶”,此公共晶面就称孪晶面。

3.4

晶粒度grain size

晶粒大小的量度。铜及铜合金晶粒度通常采用“公称直径(d_n)”来表示“晶粒平均直径”。

3.5

晶粒级别指数grain degree class index number G

在100倍放大倍率下,645.16 mm²面积所包含的晶粒数 n 与 G 有如下关系: